



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20111122001A

2012 年 2 月 9 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL VSSOP (DCU) パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加のご案内

(既報 67 製品からの対象除外 23 製品の連絡)

(初版 PCN20111122001 2011 年 11 月 22 日発行)

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

タイにおける大洪水の影響により、HANA 社(アユタヤ, タイ)サイトを含む数カ所の弊社協力工場における生産が、暫定的に被害を受けております。

TI は、連日、生産/流通拠点パートナーからの状況連絡を受けながら、供給面での致命的影響を緩和する為に、代替製造工場の選定及び認定を含む様々な施策を行っております。

今回のお知らせは、代替組立検査工場追加の連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為に、本通知内で明記したパッケージ製品について、追加工場への生産移管に向け早急に対応いたしております。

TI は、現行最善の情報/知識に基づき生産移管に必要な全てを本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、変更があった場合にも同様に本通知の更新版にて連絡いたします。さらに、選定された代替工場をより効率的に利用できると判断した時点で、これらに関連する供給移管に伴う PCN を発行する場合があります。

TI は、各生産拠点での認定状況を基に生産拠点選定及びパッケージ認定試験による前述の移管施策に加え、お客様への製品納入に先立ち、選別工程での歩留まり/選別分類比較評価を行う事でお客様での懸念事項の払拭に向け進めてまいります。また、供給の遅れを最小限にとどめると共に、品質を伴った製品の供給に努めてまいります。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21 日以内**に、本通知受領のご確認をお願いいたします。供給遅延を最小限にとどめるために、TI は部材供給可能な代替工場での生産を 2012 年 2 月の出荷が開始されるべくすでに施策の実施を開始いたしております。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	☒ Test	☒ Site	☐ Process	
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	下記変更について既報 67 製品からの対象除外 23 製品の連絡になります。 HVAL VSSOP (DCU) パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行 : HANA 社(アユタヤ, タイ) 変更後: HANA 社(アユタヤ, タイ), Renesas 社(日本)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2 月中旬の出荷より予定しています。 (サンプルは 2011 年 12 月上旬の出荷より実施しています。)			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更について既報67製品からの対象除外23製品の連絡になります。対象除外品は引き続きHANA社(アユタヤ, タイ)サイトにおいて製造されます。弊社 HVAL (ハイボリュームアナログロジック) VSSOP (DCU) パッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 HANA社(アユタヤ, タイ)サイトに製造していますが、HANA社(アユタヤ, タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為に、これに加えて、Renesas社(日本)サイトを追加します。組立部材変更については下表を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
組立検査サイト	HANA社(アユタヤ, タイ)	HANA社(アユタヤ, タイ) Renesas社(日本)

	現行	追加認定
組立検査サイト	Hana-Ayutthaya	Renesas
チップ接着剤	400154	RZ241C
モールド樹脂	450207	RM500F
リードフレーム端子表面処理	NiPdAu	Matte-Sn

理由: HANA 社(アユタヤ, タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為

詳細:

本変更実施以降、対象製品の鉛フリー対応製品は単一製品名に統一されます。例えば、SN74LVC2G02DCUR の製品名で Matte-Sn もしくは NiPdAu 表面処理の SN74LVC2G02DCUR 製品が出荷されることになります。

対象製品リスト

対象製品名				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
PCA9306DCUR	SN74LVC2G00DCUR	SN74LVC2G240DCUR	SN74LVC3G04DCUR	TPD4E002DRL2
SN74AUC1G74DCUR	SN74LVC2G00DCUT	SN74LVC2G32DCUR	SN74LVC3G04DCUT	TPD4E002DRLR
SN74AUC1G74DCUT	SN74LVC2G02DCUR	SN74LVC2G32DCUT	SN74LVC3G06DCUR	TS5A2053DCUR
SN74AUC2G125DCUR	SN74LVC2G02DCUT	SN74LVC2G38DCUR	SN74LVC3G06DCUT	TS5A2066DCUR
SN74AUC2G53DCUR	SN74LVC2G08DCUR	SN74LVC2G38DCUT	SN74LVC3G07DCUR	TS5A21366DCUR
SN74AUC2G66DCUR	SN74LVC2G08DCUT	SN74LVC2G53DCUR	SN74LVC3G07DCUT	TS5A23166DCUR
SN74AUC2G86DCUR	SN74LVC2G125DCUR	SN74LVC2G53DCUT	SN74LVC3G14DCUR	TS5A23166DCUT
SN74AVC2T45DCUR	SN74LVC2G125DCUT	SN74LVC2G66DCUR	SN74LVC3G14DCUT	TS5A3154DCUR
SN74CB3Q3306ADCUR	SN74LVC2G126DCUR	SN74LVC2G66DCUT	SN74LVC3G17DCUR	TS5A3357DCUR
SN74CB3T3306DCUR	SN74LVC2G126DCUT	SN74LVC2G74DCUR	SN74LVC3G34DCUR	TS5A3357DCUT
SN74LVC1G123DCUR	SN74LVC2G132DCUR	SN74LVC2G74DCUT	SN74LVC3G34DCUT	TXS0102DCUR
SN74LVC1G123DCUT	SN74LVC2G132DCUT	SN74LVC2G86DCUR	SN74LVC3306DCUR	
SN74LVC1G99DCUR	SN74LVC2G157DCUR	SN74LVC2G86DCUT	TPD2E001DRLR	
SN74LVC1G99DCUT	SN74LVC2G157DCUT	SN74LVC2T45DCUR	TPD3E001DRLR	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び ECAT コードが下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	ECAT コード
現行	Hana-Ayutthaya	ASO: HNT	ECAT: G4
追加認定	Renesas	ASO: HTC	ECAT: G3

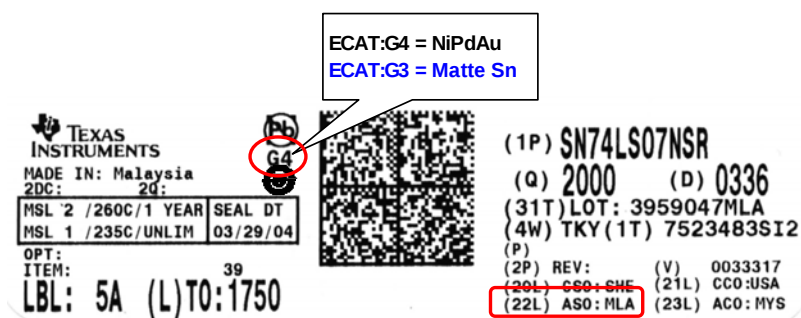


図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 12 月 14 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device :	SN74LVC2G74DCUR	-	-	
Assembly Site:	HTC-Renesas	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Mount Compound:	RZ241C	Mold Compound:	RM500F	
Bond Wire:	Au, 0.8 Mil Dia.	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300hrs	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	Approved	Approved
Solderability	Steam age, 8 hours	22/0	22/0	22/0
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22/0	22/0	22/0
Lead Fatigue	# of leads, min. 3 units	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	# of leads, min. 3 units	15/0	15/0	15/0
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method A - UL94-0	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method C - UL 1694	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Manufacturability - TQ	per mfg Site specification	Approved	-	-
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Salt Atmosphere	24 Hrs	22/0	22/0	22/0
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Bin Yield Equivalence	per mfg. Site specification	Approved	-	-
Moisture Sensitivity	per the appropriate pkg. level	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				